

证券代码：600520

证券简称：三佳科技

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-0420

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 调研：线下 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
来访人	华泰证券股份有限公司 泰康资产管理有限责任公司 西部利得基金管理有限公司
来访人类型	投资者 <input checked="" type="checkbox"/> 证券机构 <input checked="" type="checkbox"/> 新闻媒体 <input type="checkbox"/> 其他：_____
上市公司接待人员	总经理：昌望 董事会秘书：夏军 证券事务代表：毕静 信息披露专员：王如梦
接待时间	2026年4月20日10:00时
接待地点	三佳科技党群活动服务中心三楼会议室
投资者关系活动主要内容介绍	Q1:请介绍一下公司及主营业务情况。 A1:公司成立于2000年4月,公司前身是原电子工业部所属4150、4963、4524三个军工厂,2002年1月在上交所主板上市,被誉为“中华模具第一股”。2025年1月,合肥产投集团旗下合肥市创新科技风险投资有限公司通过股权收购形式成为公司控股股东。公司经过多年发展,目前核心业务涵盖半导体封装装备及智能制造业务两大板块。半导体封装装备具体包括高精度塑封模具、全自动塑封系统与切筋成型设备等;智能制造业务具体包括塑料挤出模具及配套设备、冲压轴承座及配套密封件等。半导体封装装备板块的营业收入占公司主营业务收入约70%,智能制造板块约占30%。 Q2:请问公司2025年度经营业绩情况如何?2026年第一季度报告何时披露? A2:公司2025年度实现营业收入约为3.79亿元,利润总额约为1032.77万元,归属于上市公司股东的净利润约764万元。2026年第一季度报告将于2026年4月28日披露。 Q3:请问公司2026年第一季度订单情况如何? A3:公司2026年第一季度订单情况符合公司预期。具体情况请关注公司后续披露的季报。

Q4: 公司对未来的研发有何规划?

A4: 公司确立了半导体先进封装设备研发优先策略, 落实合肥研究院建设, 积极申报国家、省、市科技攻关项目, 全力保障新品研发投入和加快研发进展。具体将以重点项目实施为引领, 持续加大研发投入, 合肥研发中心将全面启用, 不断完善研发团队激励机制, 激发研发人员的创新积极性。加强与高校、科研院所的产学研合作, 联合攻关关键核心技术, 突破技术瓶颈。抓好“100×300以内基板类压缩成型封装自动化设备关键技术研发及产业化”安徽省科技创新攻关项目的启动和实施工作, 做好车规级新能源模块精密封装系统、基板浮动封装模具、集成电路塑封后缺陷光学智能检测功能等项目的开发。

Q5: 公司收购众合半导体 51%股权后, 整合情况如何? 给公司带来哪些改变?

A5: 2025 年, 公司完成了对众合半导体的横向并购, 目前整合情况良好。本次收购直接增强了公司在国内半导体封装装备市场的领先优势, 市场地位得到进一步巩固。本次并购不仅是公司实现规模扩张的战术举措, 更是夯实核心竞争力、应对行业变局的战略选择, 通过战略协同与资源整合, 为公司在半导体封装高端装备领域的持续领先提供了坚实保障。

Q6: 公司对未来发展战略有何规划?

A6: 公司以控股型上市公司为发展定位, 致力于打造新兴产业投资与运营平台。遵循“立足安徽, 面向全球; 围绕主业, 做大做强”的指导思想, 坚持内生增长与外延并购双轮驱动的发展路径: 以内生发展夯实业务基础, 实现基本经营目标; 以外延并购完善产业布局, 实现超预期发展。不断强化核心竞争力, 实现“国内领先、国际知名”的品牌目标。

Q7: 公司现在定向增发进展情况如何?

A7: 公司非公开发行股票事项按计划推进, 目前进展顺利。

日期: 2026年4月20日